(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年11月14日(14.11.2024)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2024/232265 A1

(51) 国際特許分類:
*H01L 21/683* (2006.01) *H01L 21/3065* (2006.01)
*H01L 21/31* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/015998

(22) 国際出願日： 2024年4月24日(24.04.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2023-076689 2023年5月8日(08.05.2023) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 長山 将之 (**NAGAYAMA, Nobuyuki**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 茂山 和基(**MOYAMA, Kazuki**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 三浦 衛(**MIURA, Mamoru**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).

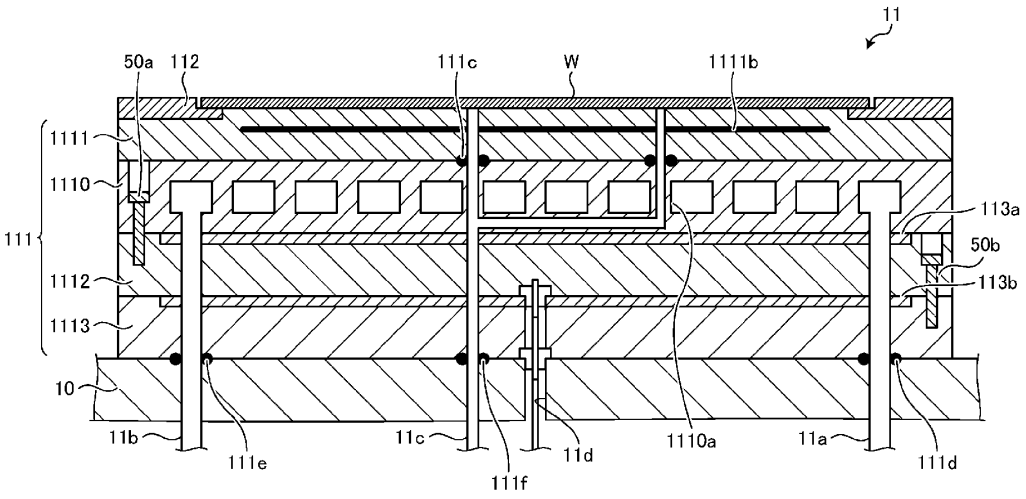
(74) 代理人: 弁理士法人酒井国際特許事務所 (**SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE**); 〒1000013 東京都千代田区霞が関３丁目８番１号 虎ノ門ダイビルイースト Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

(54) **Title:** MEMBER AND METHOD FOR MANUFACTURING MEMBER

(54) 発明の名称： 部材および部材の製造方法

[図2]




(57) **Abstract:** This member used in a semiconductor manufacturing device comprises a first member, a second member, and a seal layer disposed between the first member and the second member. The first member has a plurality of first openings, and the second member has a plurality of second openings respectively corresponding to the plurality of first openings. The seal layer has a plurality of through holes corresponding to at least two of the plurality of first openings. Each of the at least two first openings communicates with the corresponding at least two second openings via the plurality of through holes.

WO 2024/232265 A1

[続葉有]

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約:半導体製造装置に用いられる部材は、第１の部材と、第２の部材と、第１の部材と第２の部材との間に配置されるシール層とを備える。第１の部材は、複数の第１の開口を有し、第２の部材は、複数の第１の開口にそれぞれ対応する複数の第２の開口を有する。シール層は、複数の第１の開口のうち少なくとも２つのそれぞれに対応する複数の貫通孔を有する。少なくとも２つの第１の開口のそれぞれは、複数の貫通孔を介して、対応する少なくとも２つの第２の開口に連通している。